Bachelor Systems Engineering

				b = ber	notet			SP = Schrfi	itliche P	rüfung									
					Mündliche I	Prüfung		0 = Obung			1	Übersicht der zu belegenden Veranstaltungen x= Pflicht, o = Wahlpflicht							
					aktikum Prüfungsv	orloictung		u = unbeno V = Vorlesu			1								
				1.45	riululigavi	orieisturig		v - voriesu	ing		Insge	Insgesamt sind 180 CP zu belegen. Zusätzlich zu den Pflicht- und Wahlpflicht-CP müssen die restlichen CP aus dem übrigen							
				1							, v	/ahlpflicl	ht-CP müsse	n die restlich	en CP aus der	n übrigen	i		
											Leh	rverans	taltungsangel	ot (alle aufg	eführten Verar	nstaltungen)	į.		
											1	des Ba	i						
		r	I	+			_		_										
															£ .				
															. <u>ē</u>				
															De l	ing (23)	i i		
											ء ا	. D			Ξ				
											₫.	Ξ	<u>p</u>	g.	ē	gn 99 5	호 苿 호		
				RS	Zyklus	LV	sws	CP	No.	ote Prüfungsart	3	gineering	₽	뢽	뢽	richtung Enginee ab WS 22	養養量		
											, in	ë	흔폭	an ict	ġ	후교호	i ki te		
											"	ᇤ	zg tr	is di	gs	gs.	25 h e 3s		
											'5	Systems Engi	/ertiefungsrichtur Elektrotechnik	Vertiefungsrichtu Maschinenbau	Vertiefung Systeme	/ertiefungsric sustainable E beginnend al	y y st		
											5	te.	ief tro	Sc fie	tief ter	tie gin j	VS H OS		
		Modulbezeichnung	Modulelement								l š	Š	i e	/er	ys le	Verti Sust (beg	를 들는 다		
	Vorleistung	Vorpraxis in Industrie 8 Wochen	Moduleiement									x	<u>>ш</u>			× ×	i		
	Volleistung	VOLDIAXIS III IIIUUSIIIE 8 WOCHEII										^	^						
		Höhere Mathematik für Ingenieure I		1 V	VS	V+Ü	6	il	9 b	SP, PVL: Übungsaufgaben		х	Х	х	х	×	×		
	Matham matumities	Technische Physik		1 V	vs	V+Ü	5		5 b	SP/MP, PVL		x	x	x	x	×	x		
	Mathemnaturwiss.	Höhere Mathematik für Ingenieure II		2 S	SS	V+Ü	6	1	9 b	SP, PVL: Übungsaufgaben		х	X	X	х	x	×		
	Grundlagen	Höhere Mathematik für Ingenieure III		3 V	VS	V+Ü	6	;	9 b 4 b	SP, PVL: Übungsaufgaben		х	x	х	х	x	×		
ㅁ		Stochastische Bewertungsmethoden in der Technik		3 V	VS	V+Ü	3		4 b	SP/MP/PVL		х	х	х	х	х	x		
rundlagenbereich																			
e.	Ingenieurwiss. Grundlagen	Grundlagen der Elektrotechnik I		1 V	VS	V+Ü	3		5 b	SP		х	х	Х	х	х	X		
Ď		Technische Mechanik	Statik	1 V	VS	V+Ü	4		5 b	SP		х	х	х	х	x	×		
Ē			Dynamik	2 S	SS	V+Ü	4		5 b	SP		х	х	Х	х	x	x		
96		Grundlagen der Elektrotechnik II		2 S	SS	V+Ü	3	-	5 b	SP		Х	x	Х	х	X	×		
ä		Ingenieurwissenschaftliches Praktikum Messtechnik und Sensorik		2 S		V+Ü	4		3 u	SP SP		X X	X X	X X	X X	X	×		
□ ਚ		IVIESSIECHIIK UNG SENSONK		4 3	33	V+U	-	1	UID	SF		۸ .	^	^		^	!		
_ ⊆	Systemtechnische Grundlagen	Systementwicklungsmethodik 1		1 V	VS	V+Ü	4		5 b	SP/MP/PVL		х	х	Х	x	×			
2		Informationstechnik	Grundlagen	2 S	SS	V+Ü+P	5		4 b	SP, PVL: Übungsaufgaben		x	x	X	X	X	×		
Ū		Informationstechnik	Programmierpraxis	2 S	SS	V+Ü+P	5		4 b	SP, PVL: Übungsaufgaben		х	х	х	х	x	×		
_		Systemmodellierung und Simulation	Kontinuierliche Systeme	4 S		V+Ü	2		3 b	SP/PVL		x	×	×	×	×	×		
			Simulation	4 S		V+Ü	4		4 b	SP/PVL		х	x	х	х	×	×		
		Systemtheorie und Regelungstechnik 1		4 S	SS	V+Ü	3,5		5 b	SP		х	х	х	х	x	×		
		•													•				
		Elektronische Systeme		5 V	vs	V+Ü	2		3	SP/MP/PVL	0	Lehr- mit o			х				
		-		5 V		V+Ü	-		4 b	SP/MP		a E			Y	x			
		Grundlagen der Automatisierungstechnik					3		-1-		0	aus							
		Aktorik und Sensorik mit Intelligenten Materialsystemen 1		5 V		V+Ü	3	-	4 b	SP/MP	0	CP a tung			х		×		
		Aktorik und Sensorik mit Intelligenten Materialsystemen 2		6 S	SS	V+Ü	3		4 b	SP/MP/PVL	0				x		j		
	Fächergruppe Integrierte	Elektrische Klein- und Mikroantriebe		6 S	SS	V+Ü	3		4 b	SP/MP	0	12 nsta			×				
	Systeme					-			-1-			Mind. verar							
		Systemtheorie und Regelungstechnik 2		5 V	VS	V+Ü	3	:	5 b	SP/MP	О	≥ ≥			0 4. su		į		
															o Mind CP a				
		Flatness based control (Systemtheorie und Regelungstechnik 3)		5 V	vs	V+Ü	3	1	4 b	SP/MP					0 ≥0				
		0				V+Ü											!		
ي		Smarte Materialsysteme - hands on		6 S	SS	V+U	3	1	4 b	SP/MP									
Kernbereich		Grundlagen der Signalverarbeitung		3 V	MC.	V+Ü	4		6 b	SP			Х	= verans	taltungen mit o	r			
2		Elektronik	Teilmodul Phys. Grundlagen	3 V	NS	V+Ü	4	-	6 b	SP	0	Lehr- mit o	X		^		^		
e e		Licktoriik	Teilmodul Bauelemente	3 V	VS.	V+Ü	2		3 b	SP/MP	0	J.E	x						
1 2		Schaltungstechnik	Elektronische Schaltungen	3 V 4 S	SS	V+Ü	2		3 b	SP	0	aus	x		х		×		
<u> </u>			Elektrische Netzwerke	4 S	SS	V+Ü	2		3 b	SP	0	C P	x						
		Theoretische Elektrotechnik 1		4 S		V+Ü	4,5		6 b	SP	0	12 (х		х				
_		Theoretische Elektrotechnik 2		5 V	VS	V+Ü	4		5 b	SP/MP	0		x						
		Mikroelektronik 1 Elektrische Antriebe		5 V	WS	V+Ü V+Ü	3		4 b	SP SP/MP	0	Mind. veran	X X	×	X	х	X		
	Fächergruppe	Telecommunications I - Digital Transmission, Signal Processing		5 V		V+Ü	6		4 b	SP/MP/PVL	- 0	د >	x	Α		^			
	Elektrotechnik	Digital Signal Processing		6 S		V+Ü	4		6 b	SP/MP									
		Pattern and Speech Recognition (bis SoSe 2017)		5 I V	٧S	V+Ü	3		5 b	MP									
		Information Storage (bis WS 21/22)		5 V	VS	V+Ü	2		4 b	MP									
		High Frequency Engineering		5 V	٧S	V+Ü	3	1	4 b	SP/MP/PVL									
		Materialien der Mikroelektronik 1		5 V	vs	V+Ü	3		4 b	SP							X		
		Materialien der Mikroelektronik 2		6 S		V+Ü	3		4 b	SP/MP									
		Einführung in die elektromagnetische Feldsimulation		6 S		V+Ü	3		4 b	SP/MP/PVL									
		High Speed Electronics Mikroelektronik 2		6 S	SS	V+Ü V+Ü	3		4 b	SP SP									
		I THE COLONIA OF MY L	l .	0 0	,				rjv	1=1							i		

Bachelor Systems Engineering

			P = Pr	Mündliche raktikum	lündliche Prüfung Ü = Übung						Übersicht der zu belegenden Veranstallungen x= Pflicht, o = Wahlpflicht Insgesamt sind 180 CP zu belegen. Zusätzlich zu den Pflicht- und Wahlpflicht-OP müssen die restlichen CP aus dem übrigen Lehrveranstallungsangebot (alle aufgeführten Veranstaltungen) des Bachelors Systems Engineering erbracht werden.					
	Modulbezeichnung	Modulelement	RS	Zyklus	LV	sws	СР	Note	Prüfungsart		Allgemeines Studium Systems Engineering	Vertiefungsrichtung Elektrotechnik	Vertiefungsrichtung Maschinenbau	Vertiefungsrichtung Integrierte Systeme	Vertiefungsrichtung Sustainable Engineering (beginnend ab WS 22/23)	Vertiefunse ic Hung
	Elastostatik		4 8	SS	V+Ü	4		5 b	SP	0	le l		x	x		
			7 0		v.0	Ι.			-		- º			1 ^		
	Festigkeitsberechnung (bis WS 24/25)		3 V	WS	V+U	1 4		5 b	SP	0	ıstal		o o d. 4			
	Einführung in die Finite-Elemente-Methode		3 V		V+Ü	4		5 b	SP		o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	_ 0 불 8				
	Virtuelle Entwicklung (bis SoSe 23)****		6 8		V+Ü	3		4 b	SP/MP/PVL	0						
Fächergruppe Maschinenbau	Maschinenelemente und -konstruktion		5 V	NS	V+Ü	4		5 b	SP/MP/PVL	0		х				
	Technische Produktionsplanung		4 8	ss	V+Ü	2		3 b	SP/MP/PVL	0	Pat		x		aus mito	
	Technologien des Maschinenbaus		5 V		V+Ü	1		5 b	SP/MP	0	12 CP		×		o .8 CP /eran-	
						<u> </u>			SP/MP		Mind.		^		Aind taltu	
	Thermodynamik **		4 5	SS	V+Ü	4		5 b	SP/MP	0	Σ		х	o o Mind. 4 CP aus	0 ~ %	
	Strömungsmechanik **		6 5					1						。 長 氏		
					V+Ü	3		4 b						0 20		
	Montagesystemtechnik ** = aus diesen Veranstaltungen müssen mind 4 CP in der Vertiefung	erichtung Integrierte Systeme eingebracht w	5 V		V+Ü V+Ü	3		4 b	SP/MP				= Verano		o des jeweils f	ett umrandeten
	Montagesystemtechnik ** = aus diesen Veranstaltungen müssen mind. 4 CP in der Vertiefung	srichtung Integrierte Systeme eingebracht w	5 V						SP/MP				= Verans		o des jeweils f	ett umrandeten
	** = aus diesen Veranstaltungen müssen mind. 4 CP in der Vertiefung Kognitive Sensor- und Datensysteme für nachhaltige Material- und	srichtung Integrierte Systeme eingebracht w	5 V erden	WS	V+Ü	3		4 b					= Verans			ett umrandeten
	** = aus diesen Veranstaltungen müssen mind. 4 CP in der Vertiefung Kognitive Sensor- und Datensysteme für nachhaltige Material- und Produktkreisläufe	srichtung Integrierte Systeme eingebracht w	5 V	WS		3			SP/MP				= Verans		0 ,	ett umrandeten
	** = aus diesen Veranstaltungen müssen mind. 4 CP in der Vertiefung Kognitive Sensor- und Datensysteme für nachhaltige Material- und	srichtung Integrierte Systeme eingebracht w	5 V erden	ws ss	V+Ü	3		4 b		0	<u>+</u> 0		= Verans		o o nus Ver-	ett umrandeten
	** = aus diesen Veranstaltungen müssen mind. 4 CP in der Vertiefung Kognitive Sensor- und Datensysteme für nachhaltige Material- und Produktkreisläufe	srichtung Integrierte Systeme eingebracht w	erden 6 S	NS SS NS	V+Ü+S	3		4 b	SPMP	0	H it				o o nus Ver-	ett umrandeten
	** = aus diesen Veranstaltungen müssen mind. 4 CP in der Vertiefung Kognitive Sensor- und Datensysteme für nachhaltige Material- und Produktkreisläufe Einführung in die Werkstofftechnik für Ingenieure *	srichtung Integrierte Systeme eingebracht w	6 S	SS WS WS	V+Ü V+Ü+S V+Ü	3		5 b	SP/MP SP/MP/PVL	0	H it				d. 12 CP aus Ver-	ett umrandeten
Fächergruppe Allgemeines Studium	** = aus diesen Veranstaltungen müssen mind. 4 CP in der Vertiefung Kognitive Sensor- und Datensysteme für nachhaltige Material- und Produktkreisläufe Einführung in die Werkstofftechnik für Ingenieure * Einführung in die Materialwissenschaft (bis WS 24/25) *	srichtung Integrierte Systeme eingebracht w	6 S	WS SS WS WS	V+Ü+S V+Ü V+Ü	4 4 4		5 b 5 b	SP/MP SP/MP/PVL		CP aus Leh				O O CP aus Ver- ungen mit o	ett umrandeten
Fächergruppe Allgemeines Studium	** = aus diesen Veranstaltungen müssen mind. 4 CP in der Vertiefung Kognitive Sensor- und Datensysteme für nachhaltige Material- und Produktkreisläufe Einführung in die Werkstofftechnik für Ingenieure * Einführung in die Materialwissenschaft (bis WS 24/25) * Allgemeine Chemie	srichtung Integrierte Systeme eingebracht w	6 S 3 V 3 V	NS NS NS NS NS NS	V+Ü V+Ü+S V+Ü V+Ü V+Ü V+Ü V+Ü V+Ü	4 4 2,5		5 b 5 b 6 b 4 b	SPMP SPMPIPVL SPMPIPVL SP	0	12 CP aus Leh				d. 12 CP aus Ver-	ett umrandeten
	** = aus diesen Veranstaltungen müssen mind. 4 CP in der Vertiefung Kognitive Sensor- und Datensysteme für nachhaltige Material- und Produktkreisläufe Einführung in die Werkstofftechnik für Ingenieure * Einführung in die Materialwissenschaft (bis WS 24/25) * Aligmaeine Chemie Aufbaur und Verbriedungstechnik 1/Technologien der Elektronik Zuverlässigkeit 1 Mikrotechnologie (bis WS 18/19) ***	srichtung Integrierte Systeme eingebracht w	6 S 3 V 3 V 5 V 5 V 3 V 3 V 3 V 5 V	NS	V+Ü+S V+Ü V+Ü V+Ü V+Ü V+Ü V+Ü V+Ü	4 4 4 2,5 3 3 3		5 b 5 b 6 b 4 b 4 b	SPAMPIPVL SPAMPIPVL SP SP SPAMPIPVL SP SPAMPIPVL SP SPAMPIPVL SP	0 0	Mind. 12 CP aus Leh veranstaltungen mit				O O O O Mind. 12 CP aus Ver-anstal lungen mit o	ett umrandeten
	** = aus diesen Veranstaltungen müssen mind. 4 CP in der Vertiefung Kognitive Sensor- und Datensysteme für nachhaltige Material- und Produktikreisläufe Einführung in die Werkstofftechnik für Ingenieure * Einführung in die Materialwissenschaft (bis WS 24/25) * Allgemeine Chemie Außeneine Chemie Außeneine die Verbindungstechnik 1/Technologien der Elektronik Zuverlässigkeit 1 Mikrotechnologie (bis WS 18/19) *** Mikrosystemtechnik (ab WS 19/20) ***	srichtung Integrierte Systeme eingebracht w	5 V erden	NS N	V+Ü V+Ü+S V+Ü V+Ü V+Ü V+Ü V+Ü V+Ü	4 4 4 2,5 3		5 b 5 b 6 b 4 b	SPMP SPAMPIPVL SPAMPIPVL SP SPAMPIPVL	0	Mind. 12 CP aus Leh veranstaltungen mit			staltungen mit	O O O O Mind. 12 CP aus Ver-anstal lungen mit o	ett umrandeten
	** = aus diesen Veranstaltungen müssen mind. 4 CP in der Vertiefung Kognitive Sensor- und Datensysteme für nachhaltige Material- und Produktireisläufe Einführung in die Werkstofftechnik für Ingenieure * Einführung in die Materialwissenschaft (bis WS 24/25) * Allgemeine Chemie Aufbau- und Verbindungstechnik 1/Technologien der Elektronik Zuverlässigkeit 1 Mikroekenhologie (bis WS 18/19) *** Mikroevstenheichnik (ab WS 19/20)** Mikroevstenheichnik (ab WS 19/20)** Mikroevstenheichnik (ab WS 19/20)** Mikroevstenheich (ab WS 19/20)** Mikroevstenheich (ab WS 19/20)** Technische Optik	srichtung Integrierte Systeme eingebracht w	5 V 5 V 4 5 5 V	NS N	V+Û+S V+Û+S V+Û V+Û V+Û V+Û V+Û V+Û V+Û V+Û V+Û	4 4 4 2,5 3 3 3 3 3 3		5 b 5 b 6 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4	SPMPPVL SPMPPVL SP SPMPPVL SP SPMPPVL SP SPMPPVL SP SP SP SPMPPVL SP SPAPPVL SP SPAPPVL	0 0	Mind. 12 CP aus Leh veranstaltungen mit			staltungen mit	O O O O Mind. 12 CP aus Ver-anstal lungen mit o	ett umrandeten
	*** = aus diesen Veranstaltungen müssen mind. 4 CP in der Vertiefung Kognitive Sensor- und Datensysteme für nachhaltige Material- und Produktkreisläufe Einführung in die Werkstofftechnik für Ingenieure * Einführung in die Materialwissenschaft (bis WS 24/25) * Allgemeine Chemie Allgemeine Chemie Allgemeine der Elektronik Zuverflässigkeit 1 Mikrotechnologie (bis WS 18/19) *** Mikrosystemtechniche Bauelemente (bis SoSe 19) Technische Optik Mikrosysors	srichtung Integrierte Systeme eingebracht w	5 V erden 3 V 5 V 5 V 5 V 5 V 5 V 5 V 5 V 5 V 5 V	NS N	V+Û+S V+Û+S V+Û	4 4 4 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3		5 b 5 b 6 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4	SPAMP SPAMPIPVL SPAMPIPVL SP	0 0	Mind. 12 CP aus Leh veranstaltungen mit			staltungen mit	O O O O Mind. 12 CP aus Ver-anstal lungen mit o	ett umrandeten
	*** = aus diesen Veranstaltungen müssen mind. 4 CP in der Vertiefung Kognitive Sensor- und Datensysteme für nachhaltige Material- und Produktiveisläufe Einführung in die Werkstofftechnik für Ingenieure * Einführung in die Materialwissenschaft (bis WS 24/25) * Allgemeine Chemie Aufbau- und Vertindungstechnik 1/Technologien der Elektronik Zuverlässigkeit 1 Mikrosvaltentechnik (ab WS 18/19) *** Mikrosvaltentechnik (ab WS 19/20) *** Magnetische Sensorik *** avnd diesen Veranstallungen kann nur eine im Studiengang eingebr	acht werden	5 V 5 V 4 5 5 V	NS N	V+Û+S V+Û+S V+Û V+Û V+Û V+Û V+Û V+Û V+Û V+Û V+Û	4 4 4 2,5 3 3 3 3 3 3		5 b 5 b 6 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4	SPMPPVL SPMPPVL SP SPMPPVL SP SPMPPVL SP SPMPPVL SP SP SP SPMPPVL SP SPAPPVL SP SPAPPVL	0 0	Mind. 12 CP aus Leh veranstaltungen mit			staltungen mit	O O O O Mind. 12 CP aus Ver-anstal lungen mit o	ett umrandeten
	** = aus diesen Veranstaltungen müssen mind. 4 CP in der Vertiefung Kognitive Sersor- und Datensysteme für nachhaltige Material- und Produktireisläufe Einführung in die Werkstofftechnik für Ingenieure * Einführung in die Materialwissenschaft (bis WS 24/25) * Allgemeine Chemie Außau- und Verbindungstechnik 1/Technologien der Elektronik Zuverlässigkeit 1 Mikrotechnologie (bis WS 18/19) ** Mikrosystemtechnik (ab WS 19/20)** Mikrosystem	acht werden	5 V erden 6 S 3 V 3 V 5 V 5 V 4 S 5 V 5 S V 6 S 5 V 6 S	NS SS S	V+Û V+Û V+Û V+Û V+Û V+Û V+Û V+Û V+Û V+Û	4 4 4 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		5 b 5 b 6 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4	SPMPPVL SPMPPVL SPMPPVL SP SPMPPVL SPAPPVL SPAPPVL SPAPPVL SPAPPVL SP SP SP SP MP MP MP	0 0	Mind. 12 CP aus Leh veranstaltungen mit			staltungen mit	Mind. 12 CP aus Ver- anstalungen mit o	ett unrandeten
Allgemeines Studium	*** = aus diesen Veranstaltungen müssen mind. 4 CP in der Vertiefung Kognitive Sensor- und Datensysteme für nachhaltige Material- und Produktivreisläufe Einführung in die Werkstofftechnik für Ingenieure * Einführung in die Materialwissenschaft (bis WS 24/25) * Allgemeine Und Verbindungstechnik 1/Technologien der Elektronik Zuverlässigkeit 1 Mikrotechnologie (bis WS 18/19) *** Mikrosvetenstenhik (ab WS 19/20)*** Mikromechanische Bauelemente (bis SoSe 19) Technische Opitik Microsersoris Vargnetische Sensorik ** = von diesen Veranstaltungen kann nur eine im Studiengang eingebr* ** = von diesen Veranstaltungen kann nur eine im Studiengang eingebr *** = von diesen Veranstaltungen kann nur eine im Studiengang eingebr Sustaniable and Circular Englineering	acht werden	5 V erden 6 S 3 V 3 V 5 V 5 V 6 S 5 V	WS W	V+Û V+Û+S V+Û V+Û V+Û V+Û V+Û V+Û	4 4 4 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3		5 b 5 b 6 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4	SPAMP SPAMPIPVL SPAMPIPVL SP SPAMPIPVL SPAMPIPVL SP SP SP SP SP SPAMPIPVL SP MP MP MP	0 0	Mind. 12 CP aus Leh veranstaltungen mit			staltungen mit	x Mind, 12 CP aus Ver- anstiallungen mit o	ett umrandeten
Allgemeines Studium	** = aus diesen Veranstaltungen müssen mind. 4 CP in der Vertiefung Kognitive Sensor- und Datensysteme für nachhaltige Material- und Produktireisläufe Einführung in die Werkstofftechnik für Ingenieure * Einführung in die Watersalwissenschaft (bis WS 24/25) * Allgemeine Chemie Aufbau- und Verbindungstechnik 1/Technologien der Elektronik Zuverlässigkeit 1 Mikrotechnologie (bis WS 18/19) ** Mikrosystemtechnik (ab WS 19/20)** ** ** Wie diesen Veranstaltungen kann nur eine im Studiengang eingeb *** = von diesen Veranstaltungen kann nur eine im Studiengang eingeb Sustainable and Circular Engineering Einergiesysteme	acht werden bracht werden	5 V street stree	WS NS NS NS NS NS NS NS NS NS	V+Û V+Û V+Û V+Û V+Û V+Û V+Û V+Û V+Û V+Û	4 4 4 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		5 b 5 b 6 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4	SPMPPVL SPMPPVL SPMPPVL SP SPMPPVL SPAPPVL SPAPPVL SPAPPVL SPAPPVL SP SP SP SP MP MP MP	0 0	Mind. 12 CP aus Leh veranstaltungen mit			staltungen mit	Mind. 12 CP aus Ver- anstalungen mit o	ett umrandeten
Allgemeines Studium	*** = aus diesen Veranstaltungen müssen mind. 4 CP in der Vertiefung Kognitive Sensor- und Datensysteme für nachhaltige Material- und Produktivreisläufe Einführung in die Werkstofftechnik für Ingenieure * Einführung in die Materialwissenschaft (bis WS 24/25) * Allgemeine Und Verbindungstechnik 1/Technologien der Elektronik Zuverlässigkeit 1 Mikrotechnologie (bis WS 18/19) *** Mikrosvetenstenhik (ab WS 19/20)*** Mikromechanische Bauelemente (bis SoSe 19) Technische Opitik Microsersoris Vargnetische Sensorik ** = von diesen Veranstaltungen kann nur eine im Studiengang eingebr* ** = von diesen Veranstaltungen kann nur eine im Studiengang eingebr *** = von diesen Veranstaltungen kann nur eine im Studiengang eingebr Sustaniable and Circular Englineering	acht werden	5 V erden 6 S 3 V 3 V 5 V 5 V 6 S 5 V	WS NS NS NS NS NS NS NS NS NS	V+Û+S V+Û+S V+Û	3 4 4 4 4 4 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		5 b 5 b 6 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4	SPMPPVL SPMPPVL SPMPPVL SP SPMPPVL SPAPPVL SPAPPVL SPAPPVL SPAPPVL SPAMPMPVL SPMPPVL SPMPMPVL SPMPMPVL SPMPMPVL SPMPMPVL SPMPMP MP	0 0	Mind. 12 CP aus Leh veranstaltungen mit			staltungen mit	X X N N N N N N N N N N N N N N N N N N	ett umrandeten
Allgemeines Studium	*** = aus diesen Veranstaltungen müssen mind. 4 CP in der Vertiefung Kognitive Sensor- und Datensysteme für nachhaltige Material- und Produktivreisläufe Einführung in die Werkstofftechnik für Ingenieure * Einführung in die Werkstofftechnik für Ingenieure * Einführung in die Materialwissenschaft (bis WS 24/25) * Allgemeine Under Werbindungstechnik 1/Technologien der Elektronik Zuverlässigkeit 1 Mikrotechnologie (bis WS 18/19) *** Mikrosvetentechnik (ab WS 19/20)*** Mikrosvetentechnik (ab WS 19/20)*** Mikrosvetentechnik (ab WS 19/20)*** Mikrosvetentechnik (ab WS 19/20)*** Mikrosvetentenschik (ab WS 19/20)*** Mikrosvetentenschik (ab WS 19/20)*** Vermeinschaft (bis WS 19/20)*** Mikrosvetentenschik (ab WS 19/20)*** Vermeinschaft (bis WS 19/20)*** Vermeinschaft (bis WS 19/20)*** Vermeinschaft (bis WS 19/20)*** Mikrosvetentenski (ab WS 19/20)*** Vermeinschaft (bis WS 24/25) * Mikrosvetentenschik (ab WS 19/20)*** Vermeinschaft (bis WS 19/20)*** Vermeinschaft (bis WS 19/20)** Vermeinschaft (bis WS 19/	acht werden bracht werden	5 V street stree	WS NS NS NS NS NS NS NS NS NS	V+Û+S V+Û	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		5 b 5 b 6 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4	SPMP SPMPIPVL SPMPIPVL SP SP SPAMPIPVL SP SP SP SP SP SPAMPIPVL SP SP SPAMPIPVL SP MP MP MP MP SP SP SP SP SP	0 0	Mind. 12 CP aus Leh veranstaltungen mit			staltungen mit	X X X MMd 42 CP assa Vor-arestal targen mit o	ett umrandeten
Allgemeines Studium	*** = aus diesen Veranstaltungen müssen mind. 4 CP in der Vertiefung Kognitive Sensor- und Datensysteme für nachhaltige Material- und Produktivreisläufe Einführung in die Werkstofftechnik für Ingenieure * Einführung in die Werkstofftechnik für Ingenieure * Einführung in die Materialwissenschaft (bis WS 24/25) * Allgemeine Under Werbindungstechnik 1/Technologien der Elektronik Zuverlässigkeit 1 Mikrotechnologie (bis WS 18/19) *** Mikrosvetentechnik (ab WS 19/20)*** Mikrosvetentechnik (ab WS 19/20)*** Mikrosvetentechnik (ab WS 19/20)*** Mikrosvetentechnik (ab WS 19/20)*** Mikrosvetentenschik (ab WS 19/20)*** Mikrosvetentenschik (ab WS 19/20)*** Vermeinschaft (bis WS 19/20)*** Mikrosvetentenschik (ab WS 19/20)*** Vermeinschaft (bis WS 19/20)*** Vermeinschaft (bis WS 19/20)*** Vermeinschaft (bis WS 19/20)*** Mikrosvetentenski (ab WS 19/20)*** Vermeinschaft (bis WS 24/25) * Mikrosvetentenschik (ab WS 19/20)*** Vermeinschaft (bis WS 19/20)*** Vermeinschaft (bis WS 19/20)** Vermeinschaft (bis WS 19/	acht werden bracht werden	5 V street stree	WS NS NS NS NS NS NS NS NS NS	V+Û+S V+Û	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		5 b 5 b 6 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4	SPMP SPMPIPVL SPMPIPVL SP SP SPAMPIPVL SP SP SP SP SP SPAMPIPVL SP SP SPAMPIPVL SP MP MP MP MP SP SP SP SP SP	0 0	Mind. 12 CP aus Leh veranstaltungen mit			staltungen mit	X X X MMd 42 CP assa Vor-arestal targen mit o	
Allgemeines Studium	*** = aus diesen Veranstaltungen müssen mind. 4 CP in der Vertiefung Kognitive Sensor- und Datensysteme für nachhaltige Material- und Produktivreisläufe Einführung in die Werkstofftechnik für Ingenieure * Einführung in die Werkstofftechnik für Ingenieure * Einführung in die Materialwissenschaft (bis WS 24/25) * Allgemeine Under Werbindungstechnik 1/Technologien der Elektronik Zuverlässigkeit 1 Mikrotechnologie (bis WS 18/19) *** Mikrosvetentechnik (ab WS 19/20)*** Mikrosvetentechnik (ab WS 19/20)*** Mikrosvetentechnik (ab WS 19/20)*** Mikrosvetentechnik (ab WS 19/20)*** Mikrosvetentenschik (ab WS 19/20)*** Mikrosvetentenschik (ab WS 19/20)*** Vermeinschaft (bis WS 19/20)*** Mikrosvetentenschik (ab WS 19/20)*** Vermeinschaft (bis WS 19/20)*** Vermeinschaft (bis WS 19/20)*** Vermeinschaft (bis WS 19/20)*** Mikrosvetentenski (ab WS 19/20)*** Vermeinschaft (bis WS 24/25) * Mikrosvetentenschik (ab WS 19/20)*** Vermeinschaft (bis WS 19/20)*** Vermeinschaft (bis WS 19/20)** Vermeinschaft (bis WS 19/	acht werden bracht werden	5 V street stree	WS NS NS NS NS NS NS NS NS NS	V+Û+S V+Û	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		5 b 5 b 6 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4	SPMP SPMPIPVL SPMPIPVL SP SP SPAMPIPVL SP SP SP SP SP SPAMPIPVL SP SP SPAMPIPVL SP MP MP MP MP SP SP SP SP SP	0 0	Mind. 12 CP aus Leh veranstaltungen mit	min.		staltungen mit	X X X MMd 42 CP assa Vor-arestal targen mit o	ett umrandeten
Allgemeines Studium	** = aus diesen Veranstaltungen müssen mind. 4 CP in der Vertiefung Kognitive Sersor- und Datensysteme für nachhaltige Material- und Produktireislaufe Einführung in die Werkstofftechnik für Ingenieure * Einführung in die Waterialwissenschaft (bis WS 24/25) * Allgemeine Chemie Aufbau- und Verbindungstechnik 1/Technologien der Elektronik Zuverlässigkeit 1 Mikrotechnologie (bis WS 18/19) *** Mikrosystemtenhik (ab WS 19/20)** Mikrosystemtenhik (ab WS 19/20)** Mikrosystemtenhik (ab WS 19/20)** Mikrosensors Mikrosystemtenhik (ab WS 19/20)** ** = von diesen Veranstaltungen kann nur eine im Studiengang eingeb "** = von diesen Veranstaltungen kann nur eine im Studiengang eingeb Sustainable and Circular Engineering Einergiesysteme Recycling Technologien Nachhaltige Materialien	acht werden bracht werden	5 V C C C C C C C C C	SS WS W	V+Û+S V+Û	4 4 4 4 4 4 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2		5 b b 5 b 6 6 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b	SPMPPVL SPMPIPVL SPMPIPVL SP SPMPIPVL SPMPIPVL SPMPIPVL SP SPMPIPVL SP SPMPIPVL SP SPMPIPVL SP SPMPIPVL SPAMP MP MP MP SP S	0 0	Mind. 12 CP aus Leh veranstaltungen mit	min.	, x	staltungen mit	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
Allgemeines Studium	*** = aus diesen Veranstaltungen müssen mind. 4 CP in der Vertiefung Kognitive Sensor- und Datensysteme für nachhaltige Material- und Produktivelsläufe Einführung in die Werkstofftechnik für Ingenieure * Einführung in die Materialwissenschaft (bis WS 24/25) * Allgemeine Chemie Aufbau- und Verbindungstechnik 1/Technologien der Elektronik Zuverlässigkeit 1 Aufbau- und Verbindungstechnik 1/Technologien der Elektronik Zuverlässigkeit 1 Mistrosystemtechnik (ab WS 18/19) ** Echnische Optik Mistrosystemtechnik (ab WS 18/19) ** Lechnische Optik Mistrosystemtechnik (ab WS 18/19) ** Lechnische Grein Veranstaltungen kann nur eine im Studiengang eingebrat von diesen Veranstaltungen kann nur eine im Studiengang eingebrat von diesen Veranstaltungen kann nur eine im Studiengang eingebrat von diesen Veranstaltungen kann nur eine im Studiengang eingebrat von diesen Veranstaltungen kann nur eine im Studiengang eingebrat von diesen Veranstaltungen kann nur eine im Studiengang eingebrat von diesen Veranstaltungen kann nur eine im Studiengang eingebrat von diesen Veranstaltungen kann nur eine im Studiengang eingebrat von diesen Veranstaltungen kann nur eine im Studiengang eingebrat von diesen Veranstaltungen kann nur eine im Studiengang eingebrat von diesen Veranstaltungen kann nur eine im Studiengang eingebrat von diesen Veranstaltungen kann nur eine im Studiengang eingebrat von diesen Veranstaltungen kann nur eine im Studiengang eingebrat von diesen Veranstaltungen kann nur eine im Studiengang eingebrat von diesen Veranstaltungen kann nur eine im Studiengang eingebrat von diesen Veranstaltungen kann nur eine im Studiengang eingebrat von diesen Veranstaltungen kann nur eine im Studiengang eingebrat von diesen Veranstaltungen kann nur eine im Studiengang eingebrat von diesen Veranstaltungen kann nur eine im Studiengang eingebrat von diesen Veranstaltungen kann nur eine im Studiengang ei	acht werden bracht werden	5 V C C C C C C C C C	SS WS W	V+Û+S V+Û+S V+Û V+Û	3 3 4 4 4 4 4 4 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2		5 b b 5 b b 5 b b 6 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 b 4 4 b 4 b 4 4 b 4 b 4 4 b	SPMP SPAMPIPVL SPAMP	0 0	Mind. 12 CP aus Leh veranstaltungen mit	min.	, x	staltungen mit	X X X MMd 42 CP assa Vor-arestal targen mit o	
Allgemeines Studium	** = aus diesen Veranstaltungen müssen mind. 4 CP in der Vertiefung Kognitive Sensor- und Datensysteme für nachhaltige Material- und Produktireisläufe Einführung in die Werkstofftechnik für Ingenieure * Einführung in die Werkstofftechnik für Ingenieure * Einführung in die Materialwissenschaft (bis WS 24/25) * Allgemeine Chemie Aufbau- und Verbindungstechnik 1/Technologien der Elektronik Zuverlässigkeit 1 Mikrotechnologie (bis WS 18/19) ** Mikrosystemtechnik (ab WS 18/19) ** Mikrosystemtechnik (ab WS 19/20)** Mikrosystemtechnik (ab WS 19/20)** Mikrosystemtechnik (ab WS 18/19) ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	acht werden bracht werden	S V S	WS SSS WS WS WS WS WS WS WS WS	V+Û V+Û	3 3 4 4 4 4 4 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2		4 b 5 b b 6 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b 4 b	SPMPPVL SPMPIPVL SPMPIPVL SP SPMPIPVL SPMPIPVL SPMPIPVL SP SPMPIPVL SP SPMPIPVL SP SPMPIPVL SP SPMPIPVL SPAMP MP MP MP SP S	0 0	Mind. 12 CP aus Leh veranstaltungen mit	min.	, x	staltungen mit	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
Fächergruppe Sustainable Engineering Fächergruppe Management und	** = aus diesen Veranstaltungen müssen mind. 4 CP in der Vertiefung Kognitive Sensor- und Datensysteme für nachhaltige Material- und Produktireisläufe Einführung in die Werkstofftechnik für Ingenieure * Einführung in die Werkstofftechnik für Ingenieure * Einführung in die Materialwissenschaft (bis WS 24/25) * Allgemeine Chemie Aufbau- und Verbindungstechnik 1/Technologien der Elektronik Zuverlässigkeit 1 Mikrotechnologie (bis WS 18/19) ** Mikrosystemtenknik (ab WS 18/19) ** Mikrosystemtenknik (ab WS 18/19) ** Mikrosystemtenknik (ab WS 18/19) ** Mikrosystemtenen Veranstaltungen kann nur eine im Studiengang eingeb ** ** = von diesen Veranstaltungen kann nur eine im Studiengang eingeb Sustainable and Circular Engineering Energiesysteme Recycling Technologien Nachhaltige Materialien Patent- und Innovationsmanagement (bis WS 18/19) Zirkuläres Wirtschaften Innovations- und Gründungsmanagement Unternehmensgründung Gewerbliche Schutzrechte - Schwerpunkt Patentrecht	acht werden bracht werden	5 V 6 S V	WS	V+Û V+Û	3 3 4 4 4 4 4 4 4 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		5 b b 6 b 4 4 b 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 6 b 4 4 b 6 6 b 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	SPMP SPMPIPVL SPMPIPVL SP SP SPMPIPVL SP	0 0	o Mind, 12 CP aus Leh weranstalfungen mit	min.	, x	staltungen mit	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
Allgemeines Studium Fächergruppe Sustainable Engineering Fächergruppe	*** = aus diesen Veranstaltungen müssen mind. 4 CP in der Vertiefung Kognitive Sensor- und Datensysteme für nachhaltige Material- und Produktivelslade Einführung in die Werkstofftechnik für Ingenieure * Einführung in die Waterialwissenschaft (bis WS 24/25) * Allgemeine Chemie Aufbau- und Verbindungstechnik 1/Technologien der Elektronik Zuverlässigkeit 1 Witsrotechnologie (bis WS 18/19) ** Mikrotechnologie (bis WS 18/19) ** Mikrotechnologie (bis WS 18/19) ** Mikrotechnologie (bis WS 18/19) ** Elemische Option Elemische Dotti	acht werden bracht werden	5 V S	WS	V+Û + S V+Û	3 3 4 4 4 4 4 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2		5 b b 6 b 4 b b 4 b b 4 b b 4 b b 4 b b 4 b b 4 b b 4 b b 4 b b 4 b b 4 b b 4 b b 4 b b 4 b b 6 b 6 b b 6 b	SPMP SPAMPIPVL S	0 0	o Mind, 12 CP aus Leh weranstalfungen mit	min.	, x	staltungen mit	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
Fächergruppe Sustainable Engineering Fächergruppe Management und	** = aus diesen Veranstaltungen müssen mind. 4 CP in der Vertiefung Kognitive Sensor- und Datensysteme für nachhaltige Material- und Produktireisläufe Einführung in die Werkstofftechnik für Ingenieure * Einführung in die Werkstofftechnik für Ingenieure * Einführung in die Materialwissenschaft (bis WS 24/25) * Allgemeine Chemie Aufbau- und Verbindungstechnik 1/Technologien der Elektronik Zuverlässigkeit 1 Mikrotechnologie (bis WS 18/19) ** Mikrosystemtenknik (ab WS 18/19) ** Mikrosystemtenknik (ab WS 18/19) ** Mikrosystemtenknik (ab WS 18/19) ** Mikrosystemtenen Veranstaltungen kann nur eine im Studiengang eingeb ** ** = von diesen Veranstaltungen kann nur eine im Studiengang eingeb Sustainable and Circular Engineering Energiesysteme Recycling Technologien Nachhaltige Materialien Patent- und Innovationsmanagement (bis WS 18/19) Zirkuläres Wirtschaften Innovations- und Gründungsmanagement Unternehmensgründung Gewerbliche Schutzrechte - Schwerpunkt Patentrecht	acht werden bracht werden	5 V 6 S V	WS	V+Û V+Û	3 3 4 4 4 4 4 4 4 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1.	5 b b 6 b 4 4 b 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 4 b 4 6 b 4 4 b 6 6 b 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	SPMP SPMPIPVL SPMPIPVL SP SP SPMPIPVL SP	0 0	o Mind, 12 CP aus Leh weranstalfungen mit	min.	, x	staltungen mit	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	

Bachelor Systems Engineering

				b = benotet MP = Mondliche Prüfung Q = Übun,nam PVL = Prüfungsvorfeistung V = Vorfes						ng	Übersicht der zu belegenden Veranstaltungen x= Pflicht, o = Wahlpflicht Insgesamt sind 180 CP zu belegen. Zusätzlich zu den Pflicht- und Wählpflicht-CP müssen die restlichen CP aus dem übrigen Lehrvernastäutungsangebot (ale aufgeführten Veranstaltungen) des Bachelors Systems Engineering erbracht werden.					
		Modulbezeichnung	Modulelement	RS	Zyklus	LV	sws	СР	Note	Prüfungsart	Allgemeines Studium Systems Engineering	Vertiefungsrichtung Elektrotechnik	Vertiefungsrichtung Maschinenbau	Vertiefungsrichtung Integrierte Systeme	Vertiefungsrichtung Sustainable Engineering (beginnend ab WS 22/23)	Vertietungs-lic htung Mikrosystemtechn ik nicht mehr wählber ab WS 1920 -
													max. 8 CP			max. 8 CP
		Projektorsktikum Mesetechnik I	T	#	22121	Р	2.4	2 5	l	SPIMP				min. 3 CP		
		Projektpraktikum Messtechnik I Praktikum Materialien der Mikroelektronik (bis WS 18/19)		6 S	VS/SS S	P	2-4	2-5	u	MP						
		Projektpraktikum Mikrointegration und Zuverlässigkeit		6 S		Р	2-4			SP/MP						
		Projektpraktikum Antriebstechnik		6 S	S	Р	4-8		u	SP/MP						
		Projektpraktikum zu den Grundlagen der Regelungstechnik		6 S		P	2-4			SP/MP SP/MP						
â	_	Projektpraktikum Elektromagnetische Strukturen Projektpraktikum Produktentwicklung ****			VS/SS VS/SS	P	5	3-5 6	u	SP/MP/PVL			x			
Praktika	ti ka	Projektpraktikum "Aufbau eines Mikrosystems"			VS/SS	P	3	3		SP/MP						X
쑱	j ž	Praktikum Automatisierungs- und Energiesysteme		6 S	iS .	P	2	3	u	SP/MP						
2		Praktikum Schaltungstechnik ##		6 S	S	Р	2	3	u	SP		х				X
ш.		Praktikum Grundlagen der Elektrotechnik ##		6 W		Р	2	3		SP/MP		х				
		Projektpraktikum Intelligente Materialsysteme		6 W		P	2-4			SP/MP SP/MP						
		Mikrocontroller-Projektpraktikum Projektpraktikum Mikroelektronik	<u> </u>	6 S	VS/SS	P	4	3-6		SP/MP SP/MP						
		Projektpraktikum Modellierung, Simulation und Optimierung			VS/SS	P	2-4			SP/MP						
		Projektpraktikum Python for Engineers		6 S	iS	Р	2	3		SP/MP						
		**** = von diesen Veranstaltungen müssen mind. 4 CP in der Vertiefu														
		Studium generale (max. 6 CP)	Sprachkurs	1					lu	I .						
듯		otadian gonordio (max. o or)	Sonstiges universitäres Angebot													
∺	l 5		unbelegte V, V+U des Kernbereichs						-							
<u> </u>	reich	Natur- und ingwiss. Lehrveranstaltungen	Systems Engineering					max. 21 CP	b							
ahlbereich	Wahibe		Seminar aus Fächergruppe Seminare	1			_	max. 3	b						X	
	l ah		Perspektiven der Ingenieurwissenschaften Physikvertiefungsvorlesungen	1 W	VS	V	2	2	u	SP						
/a	>		Real time / embedded control													
≥		Tutortätigkeit						max. 4								
		Tutortalgical						IIIIGA. T	ļu							
				#												
S h	ø	Projektseminar														
l ie	<u>sn</u>			6		PS		6	В	SP/MP	х	X	Х	х	x	X
SC er	Schl	Bachelor-Seminar		6		s		3	В		×	×	×	×	×	×
Abschlus s-bereich	Ä								_							
- 4		Bachelor-Arbeit		6				12	В		х	Х	Х	X	х	X
											1	Alle Anga	ben in CP			
	1		Modul- RS Zyklus LV SWS	CP	Note	Prüfungs	Ī					l	1			
		Modulbezeichnung	element #	CP	Note	art				Mathematisch-naturwiss. Grundlagen	36	36	36	36	36	36
		Seminar aus der Elektronik und Schaltungstechnik		2 3 b		MP MP	l			Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen	29	29	29	29 25	29 25	29
		Seminare aus Theoretischer Elektrotechnik Seminar zur Antriebstechnik	6 WS/SS S 2	2 3 b 2 3 b		MP				Systemtechnische Grundlagen Fächergruppe Integrierte Systeme	25 12	25	25 0	23	4	25 4
9		Seminare aus der Messtechnik	6 WS/SS S 2	2 3 b		MP				Fächergruppe Elektrotechnik	12	40	4	23	4	17
<u> </u>	a.e	Seminar Automatisierungs- und Energiesysteme	6 WS/SS S 2	2 3 b		MP				Fächergruppe Maschinenbau	12	0	27	9	8	0
-	Ë	Seminare aus Mikromechanik/Mikrofluidik (bis SoSe19) Seminar zur Systemtheorie und Regelungstechnik	6 WS/SS S 2	2 3 b 2 3 b		MP MP	l			Fächergruppe Allgemeines Studium Fächergruppe Sustainable Engineering	12	0	0	4	12 14	18
Ē	l e	Seminar zur Systemineone und Regelungstechnik Seminar zur Konstruktionstechnik	6 WS/SS S 2	2 3 b		MP				Fächergruppe Organisation & Management	2	2	2	2	4	2
Seminare		Seminar Intelligente Materialsysteme	6 WS/SS S 2	2 3 b 2 3 b		MP	1			Praktika	0	6	6	3	0	6
•		Seminar zu Materialien der Mikroelektronik	6 WS/SS S 2	2 3 b		MP	1			Wahlbereich	0	0	0	0	2	0
		Seminar Technische Mechanik	6 WS/SS S 2	2 3 b		MP	l			Abschlussbereich	21	21	21	21	21	21
		Seminar Zuverlässigkeit/Aufbau- und Verbindungstechnik	6 WS/SS S 2	2 3 b		MP	ı									
	# = das Semester in dem die Vers	instaltung spätestens erbracht werden muss um das Studium innerhalb der Regelsti	udienzeit abschliessen zu können													
	## = in der Vertiefungsrichtung El	ektrotechnik wird empfohlen das Praktikum Grundlagen der Elektrotechnik im 3. Ser		nester zu l	belegen.											
		Stand 10.10.2025								Summe (in CP)	161	159	150	175	159	158

Stand 10.10.2025